

# 2016-2022年中国印制电路板（PCB）行业发展现状及前景战略咨询报告

## 报告目录及图表目录

智研数据研究中心 编制

[www.abaogao.com](http://www.abaogao.com)

## 一、报告报价

《2016-2022年中国印制电路板（PCB）行业发展现状及前景战略咨询报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/X05043OCQ5.html>

报告价格：印刷版：RMB 9800 电子版：RMB 9800 印刷版+电子版：RMB 10000

智研数据研究中心

订购电话： 400-600-8596(免长话费) 010-80993963

海外报告销售：010-80993963

传真： 010-60343813

Email： sales@abaogao.com

联系人： 刘老师 谭老师 陈老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

PCB（Printed Circuit Board），中文名称为印制电路板，是电子元器件的支撑体，也是电子元器件电气连接的载体。根据电路层数，可以分为单面板、双面板和多层板。多层板一般为4层板或6层板，复杂的可达几十层。单面板是指在PCB上，零件集中在一面，导线集中在另一面上。双面板即这种电路板的两面都有布线，同时在两面间有导孔（via）进行连接。多层板是指为了增加可以布线的面积，用更多单或双面的布线板。

### PCB 电路板制造流程

以最常用的四层PCB板为例，其材料成本中覆铜板的成本占比达到50%左右，余下材料成本为铜箔、胶片及各类化学品（主要包括：干膜、油墨、黑棕化用化学品、表面处理用化学品、PCB其它工艺加工用化学品）。其中覆铜板的主要材料则是玻纤布及电解铜箔，两项占比整个覆铜板材料成本的80%左右。

### 常用四层 PCB 材料成本构成

智研数据研究中心发布的《2016-2022年中国印制电路板（PCB）行业发展现状及前景战略咨询报告》共十章。首先介绍了印制电路板（PCB）相关概念及发展环境，接着分析了中国印制电路板（PCB）规模及消费需求，然后对中国印制电路板（PCB）市场运行态势进行了重点分析，最后分析了中国印制电路板（PCB）面临的机遇及发展前景。您若想对中国印制电路板（PCB）有个系统的了解或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

### 报告目录：

#### 第一章 印制电路板（PCB）的相关概述

##### 1.1 PCB的介绍

###### 1.1.1 PCB的定义

###### 1.1.2 PCB的分类

###### 1.1.3 PCB的历史

##### 1.2 PCB的产业链

- 1.2.1 PCB产业链的构成
- 1.2.2 产业链中的产品介绍

## 第二章 2014-2016年国际PCB产业发展分析

- 2.1 2014-2016年全球PCB产业发展概况
  - 2.1.1 国际重点PCB制造企业的概述
  - 2.1.2 2014年全球PCB工业发展回顾
  - 2.1.3 2015年全球PCB行业发展状况
  - 2.1.4 2016年全球PCB产业发展动态综述
  - 2.1.5 国外印制电路板制造技术的发展
- 2.2 美国
  - 2.2.1 美国PCB产业的发展概况
  - 2.2.2 美国PCB主要生产厂家的发展
  - 2.2.3 北美PCB产业发展现状
- 2.3 欧洲
  - 2.3.1 欧洲PCB产业发展概况
  - 2.3.2 欧洲PCB行业发展开始恢复
  - 2.3.3 德国PCB产业的发展
- 2.4 日本
  - 2.4.1 日本PCB产业的发展阶段
  - 2.4.2 日本PCB产业的业发展回顾
  - 2.4.3 2014-2016年日本PCB产业的发展
  - 2.4.4 日本领先PCB厂商发展高端路线
- 2.5 台湾地区
  - 2.5.1 2014-2015年台湾PCB产业的发展
  - 2.5.2 2016年台湾PCB产业的发展
  - 2.5.3 台湾PCB企业在大陆市场的发展动态

## 第三章 2014-2016年中国PCB产业发展分析

- 3.1 2014-2016年我国PCB产业的发展概况
  - 3.1.1 我国PCB产业的产值及产能
  - 3.1.2 我国PCB产业的产品结构

- 3.1.3 我国PCB行业配套日渐完善
- 3.1.4 我国成全球最大PCB制造基地
- 3.1.5 我国PCB产业的发展机遇
- 3.2 PCB产业竞争力分析
  - 3.2.1 竞争对手
  - 3.2.2 替代品
  - 3.2.3 潜在进入者
  - 3.2.4 供应商的力量
- 3.3 HDI市场发展分析
  - 3.3.1 HDI市场容量
  - 3.3.2 HDI市场供求
  - 3.3.3 HDI市场趋势
- 3.4 我国PCB产业发展问题及对策
  - 3.4.1 我国PCB产业与国外存在的差距
  - 3.4.2 PCB产业发展面临的挑战
  - 3.4.3 PCB产业持续发展的措施
  - 3.4.4 PCB产业需发展民族品牌

#### 第四章 中国印制电路板制造业财务状况

- 4.1 中国印制电路板制造业经济规模
  - 4.1.1 2014-2016年印制电路板制造业销售规模
  - 4.1.2 2014-2016年印制电路板制造业利润规模
  - 4.1.3 2014-2016年印制电路板制造业资产规模
- 4.2 中国印制电路板制造业盈利能力指标分析
  - 4.2.1 2014-2016年印制电路板制造业亏损面
  - 4.2.2 2014-2016年印制电路板制造业销售毛利率
  - 4.2.3 2014-2016年印制电路板制造业成本费用利润率
  - 4.2.4 2014-2016年印制电路板制造业销售利润率
- 4.3 中国印制电路板制造业营运能力指标分析
  - 4.3.1 2014-2016年印制电路板制造业应收账款周转率
  - 4.3.2 2014-2016年印制电路板制造业流动资产周转率
  - 4.3.3 2014-2016年印制电路板制造业总资产周转率

- 4.4 中国印制电路板制造业偿债能力指标分析
  - 4.4.1 2014-2016年印制电路板制造业资产负债率
  - 4.4.2 2014-2016年印制电路板制造业利息保障倍数
- 4.5 中国印制电路板制造业财务状况综合分析
  - 4.5.1 印制电路板制造业财务状况综合评价
  - 4.5.2 影响印制电路板制造业财务状况的经济因素分析

## 第五章 2014-2016年PCB制造技术的研究

- 5.1 PCB芯片封装焊接方法及工艺流程的阐述
  - 5.1.1 PCB芯片封装的介绍
  - 5.1.2 PCB芯片封装的主要焊接方法
  - 5.1.3 PCB芯片封装的流程
- 5.2 光电PCB技术
  - 5.2.1 光电PCB的概述
  - 5.2.2 光电PCB的光互连结构原理
  - 5.2.3 光学PCB的优点
  - 5.2.4 光电PCB的发展阶段
- 5.3 PCB技术的发展趋势
  - 5.3.1 向高密度互连技术方向发展
  - 5.3.2 组件埋嵌技术的发展
  - 5.3.3 材料开发的提升
  - 5.3.4 光电PCB的前景广阔
  - 5.3.5 先进设备的引入

## 第六章 2014-2016年PCB上游原材料市场分析

- 6.1 铜箔
  - 6.1.1 铜箔的相关概述
  - 6.1.2 铜箔在柔性印制电路中的应用
  - 6.1.3 电解铜箔产业的发展概况
- 6.2 环氧树脂
  - 6.2.1 环氧树脂的相关概述
  - 6.2.2 环氧树脂的主要应用领域

### 6.2.3 我国环氧树脂产业的发展现状

## 6.3 玻璃纤维

### 6.3.1 玻璃纤维的相关概述

### 6.3.2 我国成为全球最大玻璃纤维生产国

### 6.3.3 2014年我国玻璃纤维行业发展状况

### 6.3.4 2015年玻璃纤维产业运行分析

### 6.3.5 2016年玻璃纤维产业运行态势分析

## 第七章 2014-2016年PCB下游应用领域分析

### 7.1 消费类电子产品

#### 7.1.1 2014年我国消费电子产品发展综述

#### 7.1.2 2015年我国消费电子产品市场发展状况

#### 7.1.3 2016年我国消费电子产品市场发展态势

#### 7.1.4 消费电子用PCB市场需求稳定增长

#### 7.1.5 高端电子消费品市场需求带动HDI电路板趋热

### 7.2 通讯设备

#### 7.2.1 2014年我国通讯设备制造业发展

#### 7.2.2 2015年我国通信设备业的发展

#### 7.2.3 2016年我国通信设备业的发展动态

#### 7.2.4 语音通讯移动终端用PCB的发展趋势

### 7.3 汽车电子

#### 7.3.1 PCB成为汽车电子市场的热点

#### 7.3.2 多优点PCB式汽车继电器市场不断壮大

#### 7.3.3 全球汽车电子PCB市场发展预测

### 7.4 LED照明

#### 7.4.1 中国LED照明的发展状况

#### 7.4.2 LED发展为PCB行业带来新需求

## 第八章 国外重点PCB制造商介绍

### 8.1 日本企业

#### 8.1.1 日本揖斐电株式会社(IBIDEN)

#### 8.1.2 日本旗胜 ( Nippon Mektron )

- 8.1.3 日本CMK公司
- 8.2 美国企业
  - 8.2.1 MULTEK
  - 8.2.2 美国TTM
  - 8.2.3 新美亚 ( SANMINA-SCI )
  - 8.2.4 惠亚集团 ( Viasystems )
- 8.3 韩国企业
  - 8.3.1 三星电机 ( Samsung E-M )
  - 8.3.2 永丰 ( Young Poong Group )
  - 8.3.3 LG Electronics
- 8.4 台湾企业
  - 8.4.1 欣兴电子
  - 8.4.2 健鼎科技
  - 8.4.3 雅新电子

## 第九章 2014-2016年国内PCB上市公司经营状况

- 9.1 沪电股份
  - 9.1.1 企业发展概况
  - 9.1.2 企业核心竞争力
  - 9.1.3 经营效益分析
  - 9.1.4 业务经营分析
  - 9.1.5 财务状况分析
  - 9.1.6 未来前景展望
- 9.2 天津普林
  - 9.2.1 企业发展概况
  - 9.2.2 企业核心竞争力
  - 9.2.3 经营效益分析
  - 9.2.4 业务经营分析
  - 9.2.5 财务状况分析
  - 9.2.6 未来前景展望
- 9.3 生益科技
  - 9.3.1 企业发展概况



- 9.3.2 企业核心竞争力
- 9.3.3 经营效益分析
- 9.3.4 业务经营分析
- 9.3.5 财务状况分析
- 9.3.6 未来前景展望
- 9.4 超声电子
  - 9.4.1 企业发展概况
  - 9.4.2 企业核心竞争力
  - 9.4.3 经营效益分析
  - 9.4.4 业务经营分析
  - 9.4.5 财务状况分析
  - 9.4.6 未来前景展望
- 9.5 超华科技
  - 9.5.1 企业发展概况
  - 9.5.2 企业核心竞争力
  - 9.5.3 经营效益分析
  - 9.5.4 业务经营分析
  - 9.5.5 财务状况分析
  - 9.5.6 未来前景展望
- 9.6 上市公司财务比较分析
  - 9.6.1 盈利能力分析
  - 9.6.2 成长能力分析
  - 9.6.3 营运能力分析
  - 9.6.4 偿债能力分析

## 第十章 PCB行业投资分析及前景预测 (ZY ZM)

- 10.1 PCB投资分析
  - 10.1.1 PCB行业SWOT分析
  - 10.1.2 PCB投资面临的风险
  - 10.1.3 PCB市场投资空间大
- 10.2 PCB产业发展前景预测
  - 10.2.1 国际PCB行业发展预测

- 10.2.3 未来我国PCB行业将保持高速增长
- 10.2.4 十三五期间我国PCB产业的发展重点
- 10.2.5 2016-2022年我国印制电路板产业的发展前景预测

图表目录：

- 图表：各国家/地区PCB工厂数目
- 图表：全球不同种类PCB的增长率（按产品类型分）
- 图表：电子整机及PCB的应用领域和未来发展
- 图表：全球各国PCB产值
- 图表：电子工业（半导体）和PCB工业的增长
- 图表：全球各地区PCB产值分布
- 图表：全球主要手机PCB板厂家市场占有率
- 图表：全球PCB下游应用比例
- 图表：全球PCB产品结构
- 图表：美国PCB产值变化情况
- 图表：日本PCB产量统计表
- 图表：日本PCB厂家海外产值（按产品类型分类）
- 图表：日本PCB厂家海外产值（按国家分类）
- 图表：日本PCB进出口量（按国别统计）
- 图表：日本PCB出口量（按地区统计）
- 图表：日本印制电路板设备投资额
- 图表：台湾PCB的资本构成
- 图表：台湾不同种类PCB的比例
- 图表：台湾PCB市场规模
- 图表：中国PCB产业主要本土企业销售收入增长幅度
- 图表：2014-2016年印制电路板制造业销售收入
- 图表：2014-2015年印制电路板制造业销售收入增长趋势图
- 图表：2014-2015年印制电路板制造业不同所有制企业销售额
- 图表：2015年印制电路板制造业不同所有制企业销售额对比图
- 图表：2016年印制电路板制造业不同所有制企业销售额
- 图表：2016年印制电路板制造业不同所有制企业销售额对比图
- 图表：2014-2016年印制电路板制造业利润总额

图表：2014-2015年印制电路板制造业利润总额增长趋势图

图表：2014-2015年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额

图表：2016年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额

图表：2016年印制电路板制造业不同所有制企业利润总额对比图

图表：2014-2016年印制电路板制造业资产总额

图表：2014-2015年印制电路板制造业总资产增长趋势图

图表：截至2016年印制电路板制造业不同所有制企业总资产

图表：截至2016年印制电路板制造业不同所有制企业总资产对比图

图表：2014-2016年印制电路板制造业亏损面

图表：2014-2016年印制电路板制造业亏损企业亏损总额

图表：2014-2015年印制电路板制造业销售毛利率趋势图

图表：2014-2016年印制电路板制造业成本费用率

图表：2014-2015年印制电路板制造业成本费用利润率趋势图

图表：2014-2015年印制电路板制造业销售利润率趋势图

图表：2014-2015年印制电路板制造业应收账款周转率对比图

图表：2014-2015年印制电路板制造业流动资产周转率对比图

图表：2014-2015年印制电路板制造业总资产周转率对比图

图表：2014-2015年印制电路板制造业资产负债率对比图

图表：2014-2016年印制电路板制造业利息保障倍数对比图

图表：光学PCB和传统PCB的优点对比

图表：压延退火方法制造的铜箔产品

图表：铜箔的分类

图表：电解铜箔制造过程示意图

图表：铜箔的处理阶段和稳定性

图表：环氧树脂胶粘剂的主要用途

图表：2009-2016年华东环氧树脂市场走势图

图表：全国玻璃纤维纱累计产量

图表：玻纤及制品主要进口来源地

图表：玻璃纤维及制品出口量

图表：通信设备制造业工业销售情况

图表：我国通信设备产品产量及增长

图表：我国通讯设备主要出口产品增长情况

图表：我国通讯设备主要进口产品增长情况

图表：通信设备制造业、计算机及其他电子设备制造业投资情况

图表：通信设备制造业不同所有制企业经营情况

图表：通信设备制造业不同规模企业经营情况

图表：全球手机销售量与Smart Phone市场渗透率

图表：国内LED产量、芯片产量及芯片国产率

图表：我国LED市场规模及增长率变化

图表：我国LED封装产量变化

图表：我国半导体照明应用领域

图表：国内外功率型白光LED技术指标对比

图表：2014-2016年沪电股份总资产和净资产

图表：2014-2015年沪电股份营业收入和净利润

图表：2016年沪电股份营业收入和净利润

图表：2014-2015年沪电股份现金流量

图表：2016年沪电股份现金流量

图表：2015年沪电股份主营业务收入分行业、产品、区域

图表：2014-2015年沪电股份成长能力

图表：2016年沪电股份成长能力

图表：2014-2015年沪电股份短期偿债能力

图表：2016年沪电股份短期偿债能力

图表：2014-2015年沪电股份长期偿债能力

图表：2016年沪电股份长期偿债能力

图表：2014-2015年沪电股份运营能力

图表：2016年沪电股份运营能力

图表：2014-2015年沪电股份盈利能力

图表：2016年沪电股份盈利能力

图表：2014-2016年天津普林总资产和净资产

图表：2014-2015年天津普林营业收入和净利润

图表：2016年天津普林营业收入和净利润

图表：2014-2015年天津普林现金流量

图表：2016年天津普林现金流量

图表：2015年天津普林主营业务收入分行业、产品、区域

图表：2014-2015年天津普林成长能力

图表：2016年天津普林成长能力

图表：2014-2015年天津普林短期偿债能力

图表：2016年天津普林短期偿债能力

图表：2014-2015年天津普林长期偿债能力

图表：2016年天津普林长期偿债能力

图表：2014-2015年天津普林运营能力

图表：2016年天津普林运营能力

图表：2014-2015年天津普林盈利能力

图表：2016年天津普林盈利能力

图表：2014-2016年生益科技总资产和净资产

图表：2014-2015年生益科技营业收入和净利润

图表：2016年生益科技营业收入和净利润

图表：2014-2015年生益科技现金流量

图表：2016年生益科技现金流量

图表：2015年生益科技主营业务收入分行业、产品、区域

图表：2014-2015年生益科技成长能力

图表：2016年生益科技成长能力

图表：2014-2015年生益科技短期偿债能力

图表：2016年生益科技短期偿债能力

图表：2014-2015年生益科技长期偿债能力

图表：2016年生益科技长期偿债能力

图表：2014-2015年生益科技运营能力

图表：2016年生益科技运营能力

图表：2014-2015年生益科技盈利能力

图表：2016年生益科技盈利能力

图表：2014-2016年超声电子总资产和净资产

图表：2014-2015年超声电子营业收入和净利润

图表：2016年超声电子营业收入和净利润

图表：2014-2015年超声电子现金流量

图表：2016年超声电子现金流量

图表：2015年超声电子主营业务收入分行业、产品、区域

图表：2014-2015年超声电子成长能力

图表：2016年超声电子成长能力

图表：2014-2015年超声电子短期偿债能力

图表：2016年超声电子短期偿债能力

图表：2014-2015年超声电子长期偿债能力

图表：2016年超声电子长期偿债能力

图表：2014-2015年超声电子运营能力

图表：2016年超声电子运营能力

图表：2014-2015年超声电子盈利能力

图表：2016年超声电子盈利能力

图表：2014-2016年超华科技总资产和净资产

图表：2014-2015年超华科技营业收入和净利润

图表：2016年超华科技营业收入和净利润

图表：2014-2015年超华科技现金流量

图表：2016年超华科技现金流量

图表：2015年超华科技主营业务收入分行业、产品、区域

图表：2014-2015年超华科技成长能力

图表：2016年超华科技成长能力

图表：2014-2015年超华科技短期偿债能力

图表：2016年超华科技短期偿债能力

图表：2014-2015年超华科技长期偿债能力

图表：2016年超华科技长期偿债能力

图表：2014-2015年超华科技运营能力

图表：2016年超华科技运营能力

图表：2014-2015年超华科技盈利能力

图表：2016年超华科技盈利能力

图表：2016年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表：2015年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表：2014年印制电路板行业上市公司盈利能力指标分析

图表：2016年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表：2015年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表：2014年印制电路板行业上市公司成长能力指标分析

图表：2016年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表：2015年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表：2014年印制电路板行业上市公司营运能力指标分析

图表：2016年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表：2015年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表：2014年印制电路板行业上市公司偿债能力指标分析

图表：2016-2022年中国印制电路板行业销售收入预测

详细请访问：<http://www.abaogao.com/b/dianzi/X05043OCQ5.html>